

2013年3月期 第3四半期決算概要

ルネサス エレクトロニクス株式会社

2013年2月8日

代表取締役社長 赤尾 泰

社長の赤尾でございます。

本日はご多忙のところお集まりいただき、ありがとうございます。

2013年3月期 第3四半期の決算概要についてご説明いたします。

エグゼクティブサマリ

I. 2013年3月期 第3四半期 決算概要

- 世界的な市況停滞の継続、中国向け自動車・電子機器等の生産減による半導体需要減の顕在化などにより、半導体売上高は、前四半期比14%減の1,772億円
- 営業損益は、これまでの構造対策により一定の費用削減効果が出ているものの、売上高の減少により、前四半期比で22億円悪化し、79億円の赤字

II. 2013年3月期 通期業績予想

- 上記の中国向け需要減の更なる顕在化や長引く世界的な景気停滞に伴う需要減などにより、売上高、損益とも前回予想(12月10日公表)から下方修正

III. 人的合理化施策と生産構造対策の進捗状況

- 費用構造の改善や意思決定の迅速化に加え、成長戦略に沿った設計・開発、製造、販売体制の再構築を目指し、人員構成の最適化などの更なる合理化施策を推進
- 国内後工程の3工場売却について1月30日に基本合意するなど、生産構造対策は着実に進展

こちらが本日のご説明内容のサマリでございます。

第一に、2013年3月期 第3四半期の決算概要についてです。

世界的な市況停滞の継続、中国向け自動車や電子機器等の生産減による半導体需要影響の顕在化などにより、半導体売上高は、前四半期比14%減の1,772億円になりました。

営業損益は、これまでの構造対策により一定の費用削減効果が出ているものの、売上高の減少により、前四半期比で22億円悪化し、79億円の赤字になりました。

第二に、通期の業績予想についてです。

前述したとおりの中国向け需要減の更なる顕在化や長引く世界的な景気停滞に伴う需要減などにより、売上高、損益とも12月10日に公表した前回予想から下方修正しました。

第三に、人的合理化施策と生産構造対策の進捗状況についてです。

費用構造の改善や意思決定の迅速化に加え、成長戦略に沿った設計・開発、製造、販売体制の再構築を目指し、人員構成の最適化などの更なる合理化施策を推進します。

また、国内後工程の3工場売却について1月30日に基本合意するなど、生産構造対策は着実に進展しています。

I. 2013年3月期 第3四半期 決算概要

それではまず、2013年3月期 第3四半期の決算概要についてご説明いたします。

2013年3月期 第3四半期 決算概要

- 半導体売上高は、世界的な市況停滞の継続、中国向け自動車・電子機器等の生産減による半導体需要減の顕在化などにより、前四半期比14%減の1,772億円
- 営業損益は、これまでの構造対策により一定の費用削減効果が出ているものの、売上高の減少により、前四半期比で22億円悪化し、79億円の赤字

2012年3月期		2013年3月期			
(単位:億円)	第3四半期	第2四半期	第3四半期	前四半期比	前年同期比
売上高	2,229	2,228	1,910	△318 (△14%)	△318 (△14%)
半導体売上高	1,980	2,053	1,772	△281 (△14%)	△208 (△11%)
営業損益	△40	△57	△79	△22	△40
経常損益	△36	△68	△111	△43	△75
四半期純損益	△24	△943	△466	+477	△442
1US\$=	77円	79円	79円	±0円	2円 円安
1ユーロ=	105円	98円	102円	4円 円安	3円 円高

4

© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

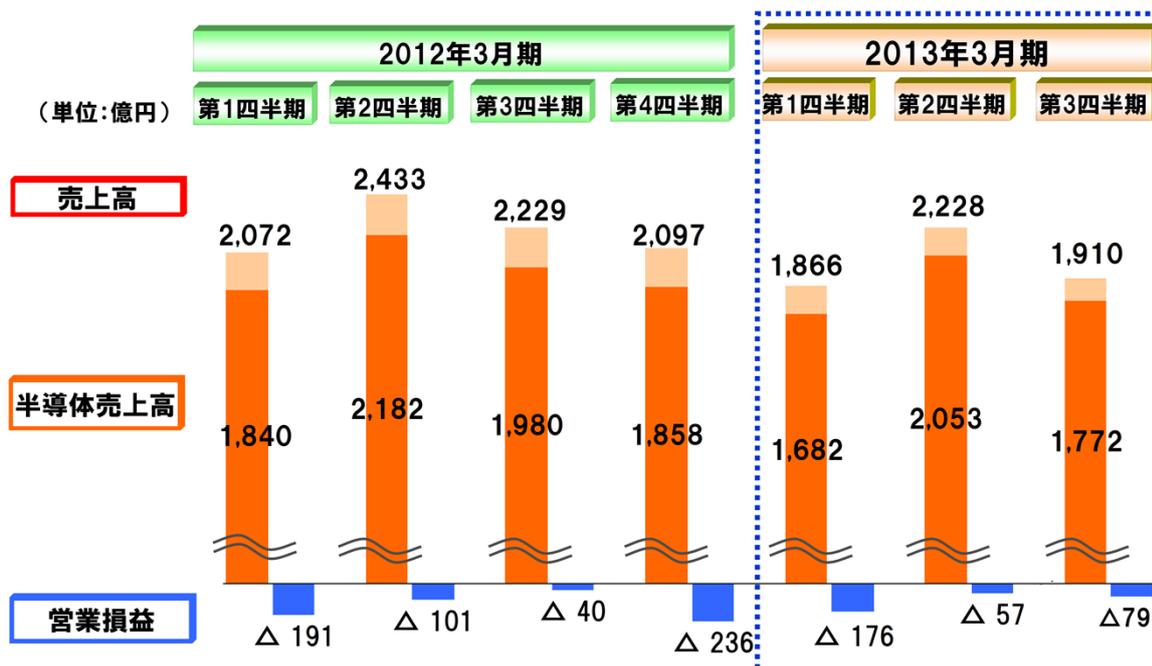
RENESAS

4ページは、第3四半期の業績のサマリです。

半導体売上高は、世界的な市況停滞の継続、中国向け自動車や電子機器等の生産減による半導体需要減の顕在化などにより、前四半期比14%減の1,772億円となりました。

営業損益は、これまでの構造対策により一定の費用削減効果が出ているものの、売上高の減少により、前四半期比で22億円悪化し、79億円の赤字となりました。

四半期業績推移



5ページは、四半期ごとの業績推移です。

先ほど申し上げましたとおり、第3四半期の半導体売上高は前四半期比14%減収となりました。営業損益は一定の費用削減効果が出ているものの、売上高の減少により、前四半期比で22億円の悪化となりました。

2013年3月期 第3四半期 半導体売上高の事業別状況①

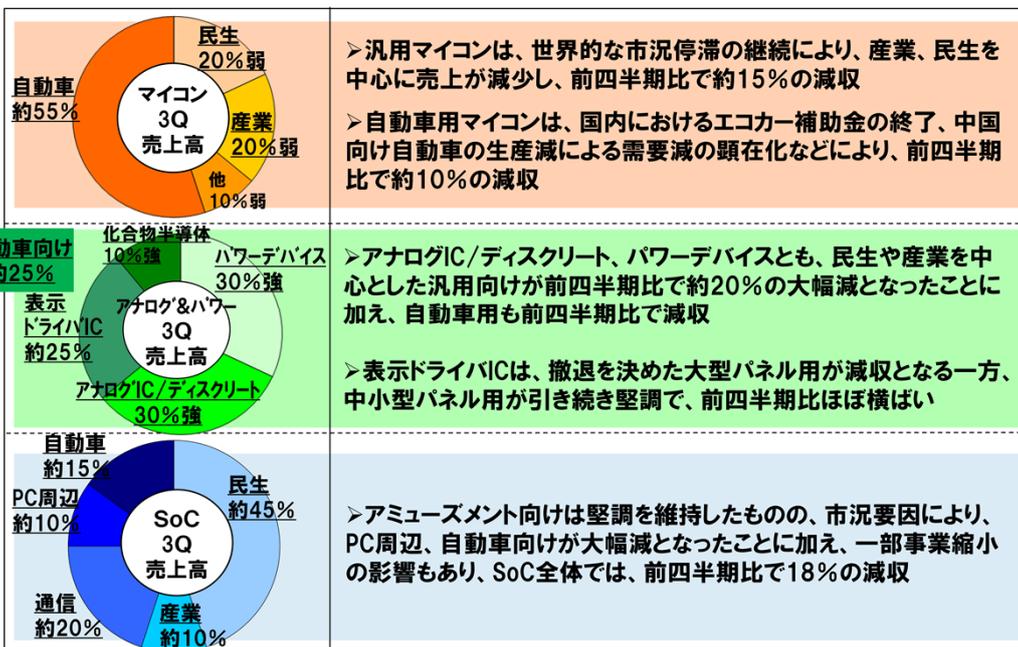
■ 第3四半期の半導体売上高は、3事業とも前四半期比で減少

(単位:億円)	2012年3月期	2013年3月期			
	第3四半期	第2四半期	第3四半期	前四半期比	前年同期比
半導体売上高 計	1,980	2,053	1,772	△281 (△14%)	△208 (△11%)
マイコン	886	809	712	△98 (△12%)	△175 (△20%)
アナログ & パワー 半導体(A&P)	545	681	578	△103 (△15%)	+33 (+6%)
SoC	534	550	451	△99 (△18%)	△83 (△16%)
その他半導体	14	13	31	+17	+17

6ページは、第3四半期の事業別の半導体売上高です。

前述したような要因により、3事業とも前四半期比で減少しました。

2013年3月期 第3四半期 半導体売上高の事業別状況②



7

© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

7ページは、第3四半期の各事業別の売上について、さらに分野別での状況を示したものです。

マイコンについては、汎用マイコンにおいて、世界的な市況停滞の継続により、産業、民生を中心に売上が減少し、前四半期比で約15%の減収となりました。

一方、自動車用マイコンは、国内におけるエコカー補助金の終了、中国向け自動車の生産減による需要減の顕在化などにより、前四半期比で約10%の減収となりました。

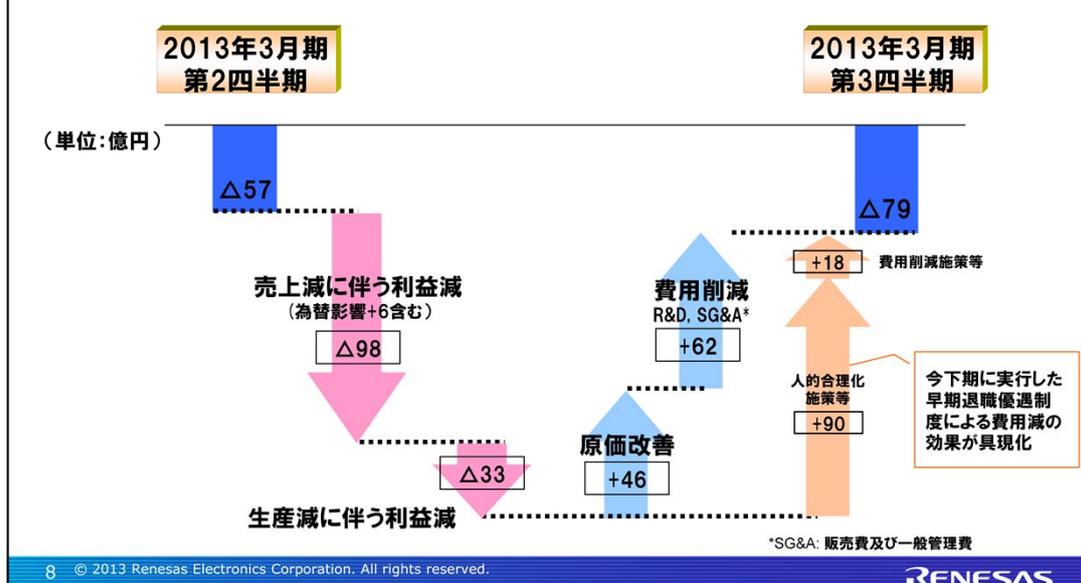
アナログ&パワー半導体については、アナログIC/ディスクリートとパワーデバイスにおいて、民生や産業を中心とした汎用向けが前四半期比で約20%の大幅減となったことに加え、自動車用も前四半期比で減収となりました。

表示ドライバICにおいては、撤退を決めた大型パネル用が減収となる一方、中小型パネル用が引き続き堅調で、前四半期比でほぼ横ばいとなりました。

SoCについては、エンターテインメント向けは堅調を維持したものの、市況要因により、PC周辺、自動車向けが大幅減となったことに加え、一部事業縮小の影響もあり、SoC全体では、前四半期比で18%の減収となりました。

2013年3月期 第3四半期 営業損益（前四半期比）

- 営業損益は、構造対策による固定費削減効果が出てきているものの、売上減に伴う利益減により、前四半期比で22億円の悪化



8ページは、第3四半期の営業損益について、前四半期からの増減で示したものです。

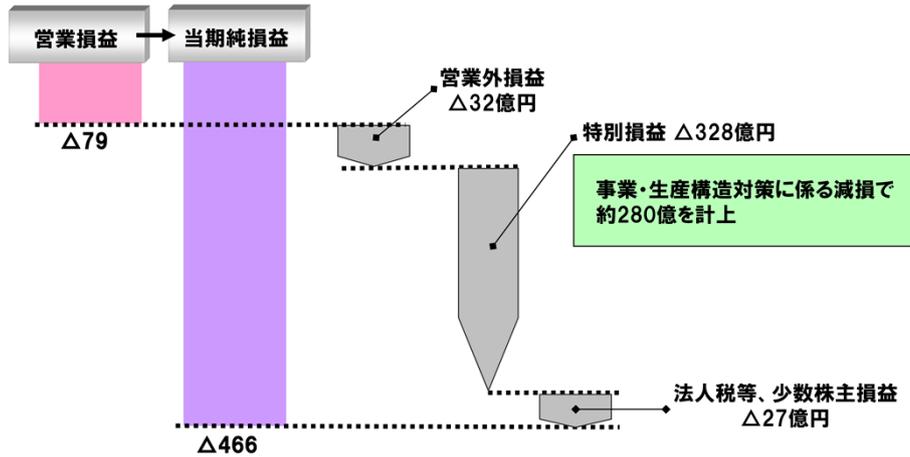
営業損益は、当第3四半期に実行した早期退職優遇制度の実施など、構造対策による固定費削減効果が出てきているものの、売上減に伴う利益減などにより、前四半期比で22億円の悪化となりました。

2013年3月期 第3四半期 当期純損益

- 事業・生産構造対策などにより、328億円の特別損益を計上し、当期純損益は466億円の赤字

2013年3月期 第3四半期

(単位:億円)



© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

9ページは、第3四半期の当期純損益について、営業損益からの増減を示したものです。

第3四半期は、事業・生産構造対策などにより、328億円の特別損益を計上し、当期純損益は466億円の赤字となりました。

特別損失の主な内訳としましては、事業・生産構造対策に係る減損約280億円を計上しています。

バランスシートの状況

(単位:億円)	12/3末	12/9末	12/12末
総資産	8,582	7,483	7,167
うち 現金及び現金同等物	1,319	696	951
うち たな卸資産	1,518	1,479	1,493
負債合計	6,317	6,414	6,433
うち 有利子負債	2,583	2,393	3,162
株主資本	2,434	1,283	817
純資産合計	2,265	1,068	734
D/Eレシオ(グロス)	1.19倍	2.46倍	5.00倍
D/Eレシオ(ネット)	0.58倍	1.74倍	3.50倍
自己資本比率	25.4%	13.0%	8.8%

(注)①現金及び現金同等物:「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3ヶ月を超える定期預金」を控除しております。
 ②有利子負債:「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「リース債務」、「長期借入金」
 ③自己資本:「株主資本」、「その他の包括利益累計額」 ④D/Eレシオ(グロス):有利子負債/自己資本

続いて、10ページは、バランスシートの状況です。

長期借入金の増加などにより現金及び現金同等物は前四半期末比で増加しました。一方、四半期純損失の計上などにより、自己資本比率は8.8%となりました。

こうした状況の中で、当社は2012年12月10日に産業革新機構及び事業会社8社を割当先とする第三者割当増資を発表しています。2013年9月30日までに総額1,500億円の払い込みが完了する予定であり、これにより、バランスシートは大きく改善する見込みです。

キャッシュ・フローの状況

- 第3四半期のフリー・キャッシュ・フローは536億円の赤字であったが、早期退職優遇制度の実施に係る一時金支払いの影響を除けば、営業キャッシュ・フローは第2四半期に続き黒字、フリー・キャッシュ・フローも黒字に回復

(単位：億円)	2012年3月期			2013年3月期			
	第3四半期	9ヶ月累計 (4-12月)	通期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	9ヶ月累計 (4-12月)
営業活動による キャッシュ・フロー	180	△31	△97	△181	46	△475	△610
投資活動による キャッシュ・フロー	△152	△477	△551	△107	△98	△61	△265
フリー・ キャッシュ・フロー	29	△508	△648	△287	△52	△536	△875

11ページは、キャッシュ・フローの状況です。

第3四半期について、フリー・キャッシュ・フローは536億円の赤字でしたが、早期退職優遇制度の実施に伴う一時金支払いの影響を除けば、営業キャッシュ・フローは第2四半期に続き黒字、フリー・キャッシュ・フローも黒字に回復しました。

II. 2013年3月期 通期業績予想

次に、2013年3月期 通期業績予想についてご説明いたします。

2013年3月期 連結業績予想の修正

- 下期にかけて一定の市況回復を見込んでいた自動車・産業機器向けや、大型カスタム案件による堅調な売上を見込んでいた民生向けなどが、中国向け自動車・電子機器等の生産減による需要減の更なる顕在化や長引く世界的な景気停滞の影響を受け、売上高を下方修正
- 通期の営業損益は260億円の赤字、当期純損益は1,760億円の赤字へ

(単位:億円)	2012年3月期			2013年3月期				
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期見通し	通期見通し	通期 前回予想 ^(*)	前回予想比 (前期比)
売上高	4,505	4,326	8,831	4,094	3,606	7,700	8,200	△500 (△1,131)
半導体売上高	4,022	3,838	7,860	3,736	3,374	7,110	7,600	△490 (△750)
営業損益	△292	△276	△568	△233	△27	△260	210	△470 (+308)
経常損益	△333	△278	△612	△244	△96	△340	100	△440 (+272)
当期純損益	△420	△206	△626	△1,151	△609	△1,760	△1,500	△260 (△1,134)
1US\$=	81円	78円	79円	80円	83円	82円	80円	2円 円安
1ユーロ=	115円	104円	109円	102円	109円	106円	103円	3円 円安

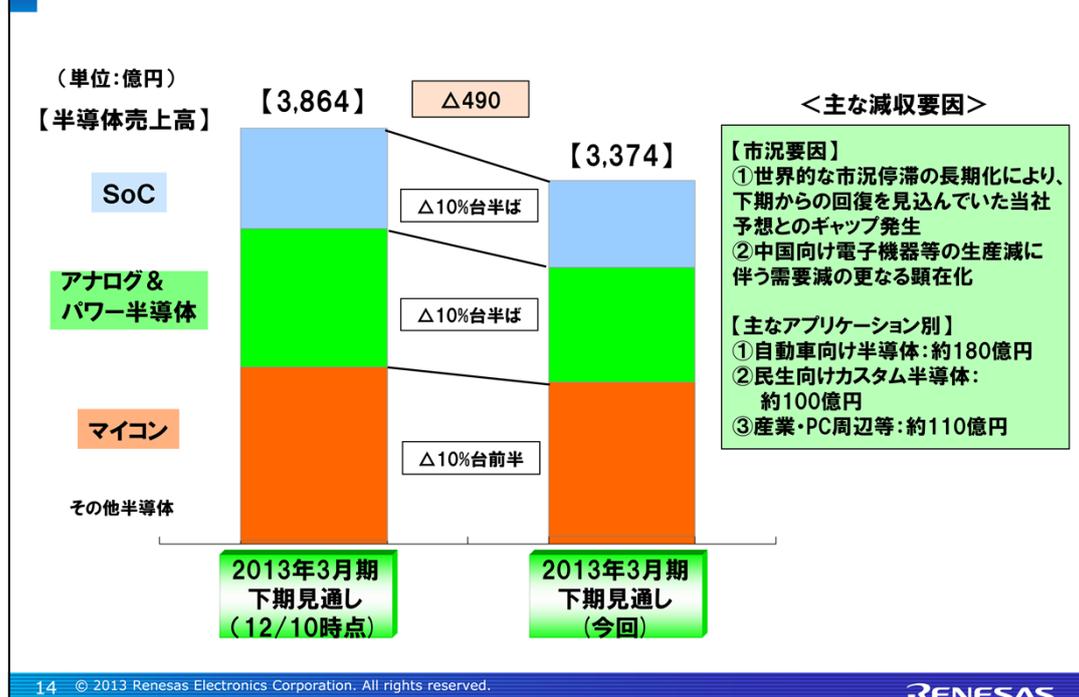
* 前回予想は12/10の業績予想修正時

通期連結業績予想については、本日別途適時開示を実施しましたが、売上高及び損益を下方修正いたしました。

通期の売上高は、12月10日に発表した予想値から500億円下回る、7,700億円の見通しに変更しました。前回予想時点では、自動車及び産業機器向けにおいて、一定の市況回復を見込み、民生向けでも、大型カスタム案件による堅調な売上を見込んでおりましたが、これら自動車、産業機器、民生向けにおいて、中国向け自動車や電子機器等の生産減による需要減の更なる顕在化や長引く世界的な景気停滞などの影響を受け、前回予想から下方修正となりました。

これにより、通期の営業損益は260億円の赤字、当期純損益は1,760億円の赤字となる見込みです。

2013年3月期 下期半導体売上見通し(前回想定比)

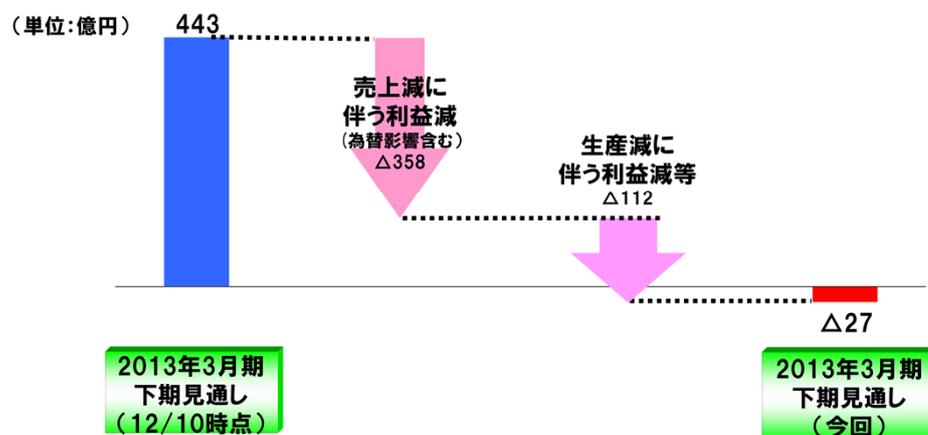


14ページは、2013年3月期の下期の半導体売上の見通しを、前回予想からの増減で示したものです。

下期の半導体売上については、昨年12月時点からの予想から今回490億円の下方修正を行い、3,374億円となる見通しです。

主な減収要因としては、世界的な市況停滞の長期化により、下期からの回復を見込んでいた当社予想とギャップが発生したことに加え、中国向け電子機器等の生産減に伴う需要減が更に顕在化したことが挙げられます。これらの要因により、SoC及びアナログ&パワー半導体で前回予想から10%台半ばの減収、マイコンで10%台前半の減収を見込んでいます。

2013年3月期 下期営業損益見通し(前回予想比)



15 © 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

15ページは、下期の営業損益を、前回予想からの増減で示したものです。

売上減に伴い利益が大きく減少することに加え、前回予想時点より生産及び棚卸資産の管理を大きく絞る結果、生産減に伴う利益減も発生し、下期の営業損益は27億円の赤字となる見込みです。

Ⅲ. 人的合理化施策と生産構造対策の進捗状況

続いて、人的合理化施策と生産構造対策の進捗状況について、ご説明いたします。

更なる合理化施策の推進

- 費用構造の改善や意思決定の迅速化に加え、成長戦略に沿った設計・開発、製造、販売体制の再構築を目指し、人員構成の最適化などの更なる合理化施策を推進

背景

- 市況の構造変化を受け、売上は減少傾向

目的

- 費用構造の改善による収益基盤の更なる強化
- 意思決定の迅速化、業務の適正化・効率化
- 成長戦略に沿った設計・開発、製造、販売体制の再構築

早期退職優遇制度の実施を労働組合に
申し入れ(13年1月17日発表)

早期退職 優遇制度

- 対象者 : 当社及び国内連結子会社の40歳以上の総合職等
- 退職予定日: 2013年9月30日
- 想定人数 : 3千数百名
- 効果・費用 : 未定 (現在諸条件について、労使協議中)

当社は、2013年1月17日に早期退職優遇制度の実施を含む更なる合理化施策の推進を発表しました。

市況の構造変化を受けて、売上が減少傾向にあるという背景に対し、費用構造の改善による収益基盤の更なる強化、意思決定の迅速化、業務の適正化・効率化、更には成長戦略に沿った設計・開発、製造、販売体制の再構築を目指し、人員構成の最適化を実現する早期退職優遇制度の実施を同日、労働組合に申し入れました。

早期退職優遇制度は、当社及び国内連結子会社の40歳以上の総合職等を対象としており、3千数百名の応募を想定しておりますが、現在諸条件について労使協議中であり、当社の連結業績に与える効果・費用は現時点で未定であります。

生産構造対策の進捗

- 2012年7月3日に生産構造対策を公表後、後工程1拠点の譲渡完了に続き新たに後工程3拠点の譲渡を決定し、生産構造対策は計画どおり進捗

	方針	現在の国内拠点数/ライン数	構造対策後の国内拠点数/ライン数
前工程	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 大口徑・微細化 ✓ 先端製品のアウトソース化 ✓ 特殊製品の自社生産継続 	9拠点 14ライン	7拠点 9ライン
後工程	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 海外生産シフトの加速 ✓ 国内外のサブコン活用強化 	8拠点 →5拠点 (13年6月予定)	2拠点

■13年1月1日 完了

- ✓ ルネサスハイコンポーネンツ(青森工場)*1をアオイ電子*2に譲渡完了

■13年1月30日 発表

- ✓ ルネサス北日本セミコンダクタの函館工場*3、ルネサス関西セミコンダクタの福井工場*4、ルネサス九州セミコンダクタの熊本工場*5を13年6月上旬にジェイデバイス*6に譲渡予定

*1:株式会社ルネサスハイコンポーネンツ(青森県北津軽郡鶴田町)

*2:アオイ電子株式会社(香川県高松市)

*3:株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 函館工場(北海道七飯町)

*4:ルネサス関西セミコンダクタ株式会社 福井工場(福井県坂井市)

*5:株式会社ルネサス九州セミコンダクタ 熊本工場(熊本県大津町)

*6:株式会社ジェイデバイス(大分県日田市)

また、2012年7月3日に国内生産拠点の再編を中心とした生産構造対策を公表しましたが、同対策の第一号案件として、青森にある後工程工場、ルネサスハイコンポーネンツのアオイ電子株式会社様への譲渡を2013年1月1日に完了しました。

これに加えて、「1年以内の譲渡を検討する」と方向性を発表していた後工程3拠点の譲渡を2013年1月30日に決定・発表し、生産構造対策は計画どおり進捗しています。本年6月上旬にルネサス北日本セミコンダクタの函館工場、ルネサス関西セミコンダクタの福井工場、ルネサス九州セミコンダクタの熊本工場を株式会社ジェイデバイス様に譲渡する予定です。

これにより、当社の日本国内の後工程拠点は5拠点となり、さらに発表した構造対策を行った後は、2拠点となる見込みです。一方、国内前工程拠点については、現在の9拠点14ラインから、構造対策後には、7拠点9ラインとなる見込みです。

機動的かつ強靱な費用構造への変革を推進

- これまで発表し、実行している人的合理化施策、事業・生産構造対策の完遂により、大幅な固定費の削減を実現し、収益構造を変革

人的合理化

事業・生産構造対策に加え、管理職を始めとする間接人員のスリム化により、13年度の人件費を12年度比で約15%削減、統合初年度の10年度比では約40%削減。

生産体制再編

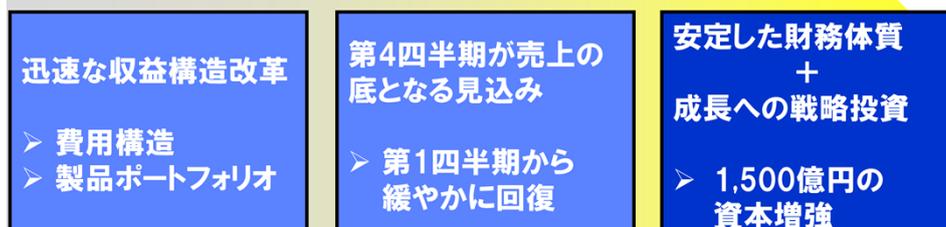
工場の譲渡、集約、規模の適正化などにより、13年度の減価償却費・リース費を12年度比で約25%削減、統合初年度の10年度比では約35%削減。

機動的かつ強靱な費用構造への変革を推進するために、これまで発表し、実行中の人的合理化施策や事業・生産構造対策を完遂することで、大幅な固定費の削減を実現します。

具体的には、人的合理化施策として、事業・生産構造対策に加え、先般発表した管理職を始めとする間接人員のスリム化を目指した早期退職優遇制度の実施により、13年度の人件費を12年度比で約15%削減し、統合初年度の10年度比では約40%削減してまいります。

生産体制再編としては、工場の譲渡、集約、規模の適正化などにより、13年度の減価償却費・リース費を12年度比で約25%削減し、統合初年度の10年度比では約35%削減してまいります。

足元での改革を推進し、新たな成長に向けた施策を実行



前ページにてお話したとおり、人的合理化や生産体制の再編などにより費用構造を改善すると共に、製品ポートフォリオの適正化も行い、当社は現在、収益構造改革を急いでおります。

一方、売上については、2013年3月期の第4四半期に底打ちし、2014年3月期の第1四半期から緩やかに回復していく見込みです。

こうした事業環境の下、当社は、足元での改革を推進しながら、安定した財務体質の確保と事業成長への戦略投資を行うべく、2012年12月に発表したとおり、産業革新機構等を割当先とする1,500億円の資本増強を2013年9月末までに実施する予定です。

まとめ

- 2013年3月期 第3四半期の半導体売上高は、前四半期比14%減の1,772億円、営業損益は、これまでの構造対策により一定の費用削減効果が出ているものの、売上高の減少により、79億円の赤字
- 通期の業績予想については、中国向け自動車・電子機器等の生産減による半導体需要減の更なる顕在化や長引く世界経済の停滞などの影響を受け、売上高、損益とも下方修正
- 費用構造の改善や意思決定の迅速化に加え、成長戦略に沿った設計・開発、製造、販売体制の再構築を目指し、人員構成の最適化などの更なる合理化施策を推進
- 新たな成長に向けた資本増強計画を控え、足元での構造改革を推進中

最後にまとめです。

2013年3月期 第3四半期の半導体売上高は、前四半期比14%減の1,772億円、営業損益は、これまでの構造対策により一定の費用削減効果が出ているものの、売上高の減少により、79億円の赤字となりました。

通期の業績予想については、中国向け最終製品の生産減による半導体需要影響の更なる顕在化や長引く世界経済の停滞などの影響を受け、売上高、損益とも下方修正しました。

費用構造の改善や意思決定の迅速化に加え、成長戦略に沿った設計・開発、製造、販売体制の再構築を目指し、人員構成の最適化などの更なる合理化施策を推進してまいります。

2012年12月に発表した、新たな成長に向けた資本増強計画を控え、足元での構造改革を推進してまいります。



(将来予測に関する注意)

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略及び業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与える重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

2013年3月期 第3四半期の決算概要のご説明は以上でございます。
本日は有難うございました。